



TG-NSP25 非矽型導熱膠泥

Non-silicone Thermal Putty

RoHS Compliant

產品特性 Features

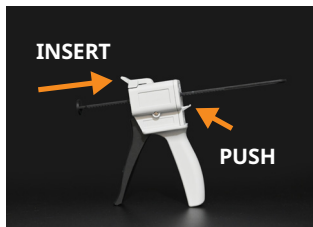
- 無矽成分的導熱凝膠
Silicone free thermal gel
- 可任意塑形與下壓
Shapeable and compressible
- 低熱阻抗
Low thermal impedance
- 無液體流動現象之困擾
No fluidity

產品應用端 Application:

適用於高速低功耗晶片 Best for high-speed or middle-power chipset

電子元件 Electronic Components - 5G, Aerospace, AI, AIoT, AR/VR/MR/XR, Automotive, Consumer Devices, Datacom, Electric Vehicle, Electronic Products, Energy Storage, Industrial, Lighting Equipment, Medical, Military, Netcom, Panel, Power Electronics, Robot, Servers, Smart Home, Telecom, etc.

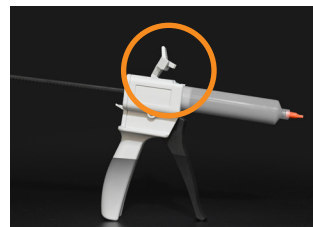
操作說明 Operation Manual



① Push the latch and insert the stick.



② Put the tube in and twist.



③ Close the cover.

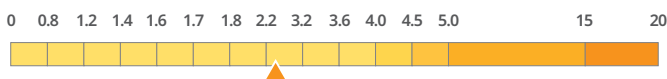


④ Take off the plug.

(圖中操作步驟所展示的膠泥僅供示意 The putty in the picture does not represent the actual product.)

產品物性 Properties

導熱係數 Thermal Conductivity : 2.6 W/m·K



Properties	Unit	TG-NSP25	Tolerance	Test Method
導熱係數 Thermal Conductivity	W/m·K	2.6	±10%	ASTM D5470 Modified
顏色 Color	-	灰 Gray	-	-
黏度 Viscosity	Pa·s	5000	-	Brookfield
密度 Density	g/cm ³	2.6	-	ASTM D792
低分子矽氧烷 Low MW Siloxane (D3-10)	ppm	0	-	GC/MS
體積電阻率 Volume Resistivity	Ohm-m	10 ¹⁴	-	ASTM D257
工作溫度 Operating Temperature	°C	-50~+150	-	-
標準包裝 Standard Package	-	針筒 Tube/ 罐裝 Pot	-	-

高柏科技 T-Global Technonology Co., Ltd.

桃園市桃園區大仁路 50 巷 33 號 No.33, Ln.50, Daren Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330058, Taiwan
 T +886-3-361-8899 E service@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version19
20240517



注意：本技術數據表內的資訊是根據高柏團隊的研究與測試得出的最佳數據。本技術數據表中列出的值僅代表典型值，並非對每一批生產的物料都進行測試。所有規格如有變更，恕不另行通知；無影響產品功能之保護膜及離型紙，如非特殊要求，皆依高柏默認為準。由於各種可能的使用條件超出了我們的控制範圍，因此我們提出的所有建議均不構成保證或責任，用戶應自行進行測試，以確定我們的產品在任何特定情況下的適用性。本產品的銷售沒有任何明示或暗示的說明，表示其適用於特定目的或其他用途的保證，但本產品應依據高柏與您確認的發票、報價、或訂單，提供最標準的產品質量。我們不承擔使用者如何延伸或改變此技術數據表中的資訊，使用者應承擔所有風險。此外，本技術數據表中的資訊不包含任何內容解釋與涉及產品材料的現有用途、未來專利衝突、工藝製造，與使用產品的建議。高柏科技為了能提供更客戶更高效能的導熱介面材料，針對部分產品更新製程並整合 UL 認證規格，自今日起我們將逐漸以 TG-A 系列料號取代部分上一代產品。